

柏第2キャンパス工学系共通機器利用のご案内

クロスセクションポリッシャー(CP) IB-19520CCP

・高速加工

厚さ1mm程度のSiウエハであれば3時間程で仕上げ加工まで完了できます。

ミリングレート 500 μ m/H (8KV, Siウエハ)

・仕上げ加工モード

高加速電圧の加工後、低加速電圧の加工に自動で切り替えて短時間で高品質な断面作製が可能です。

・冷却加工

加工時に試料を液体窒素冷却する事によりイオンビームによる熱ダメージを軽減させる事が出来ます。

(液体窒素の使用については管理者にご相談ください。)

・自動加工プログラム

設定圧力値、冷却温度に到達後、自動で加工を開始可能です。また冷却加工終了後は自動で室温まで復帰可能です。

・大気非暴露機能

加工後、試料を付けかえる事無くそのままJSM-7900F/JIB-4700Fで観察、測定可能です。また、トランスファーベッセルを用い、大気非暴露環境下で、加工から観察までを行うことができます。

・EBSDの試料作製に最適

なめらかな表面加工が実現できるためEBSD用試料の前処理にも適しています。



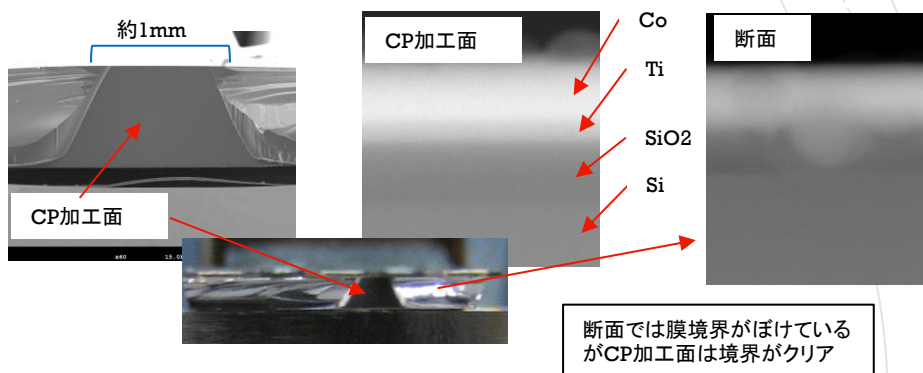
CP試料ホルダー



試料

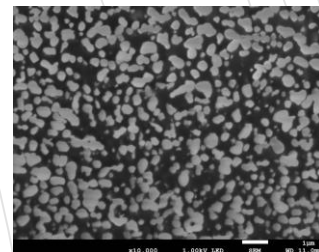
<加工例①>

Si基板上の薄膜観察



<加工例②>

金属フィラーの入った樹脂を-80℃に冷却しながら加工し観察



樹脂も金属フィラーも溶けずにはっきりと観察できている

料金表

☆代理加工もお受けいたします

利用料/hr	代理加工料金/hr
¥1,000	¥1,000

☆問い合わせ先

東京大学柏第2キャンパス 産学官民連携棟110号室 FE-SEM/FIB管理

雨宮裕之 TEL :070-3121-1645

E-mail amemiya-h★g.ecc.u-tokyo.ac.jp ※メール送信時「★」を「@」に変更してください。